

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站:www.twanfong.com

晶圓蝕刻液資訊

晶圓蝕刻液，對晶圓下面的金屬蝕刻腐蝕程度要小於 0.1μ

1. 對鈦、銅、鈷等金屬腐蝕，用雙氧水+硫酸+磷酸的混合液，酸性體系做蝕刻液。
2. 對鋁金屬腐蝕，用純MEA(PH： >12)加雙氧水到PH： 8.0 做鹼性蝕刻液。或用N-MDEA。
以上蝕刻液都要降低表面張力，鹼性體系用，HEXAFOR 641(25%，表張 15.2dyn/cm ，陰離子)可以降很低表張。酸性體系可用HEXAFOR 633(100%，表張 24.8dyn/cm ，非離子)，HEXAFOR 635(25%，表張 17.9dyn/cm ，非離子)降低表張。
3. 蝕刻液會加入抑蝕劑來減緩，可用ASCOTEC防鏽蝕、抗閃鏽劑，如果酸性體系(PH： $1.0\sim 2.0$)，可用德國Z&S公司的酸性抑蝕抗閃鏽劑。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。